

高密度実装を実現する基板内蔵用部品

Embedded Passive Devices that Achieves High Density Mounting

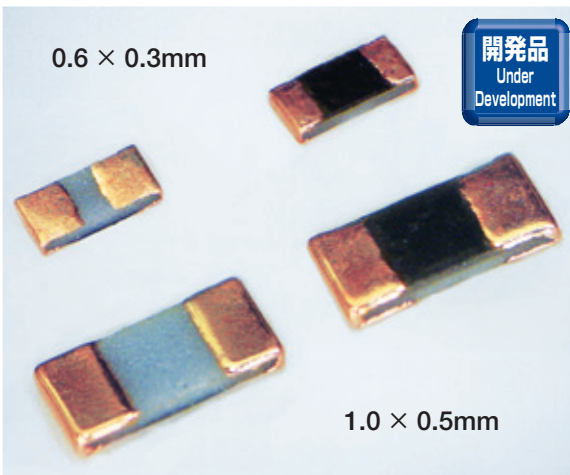
低背形受動部品 **XR73 / XL73** Resistors Inductors Low Profile Passive Components

■ 特 長

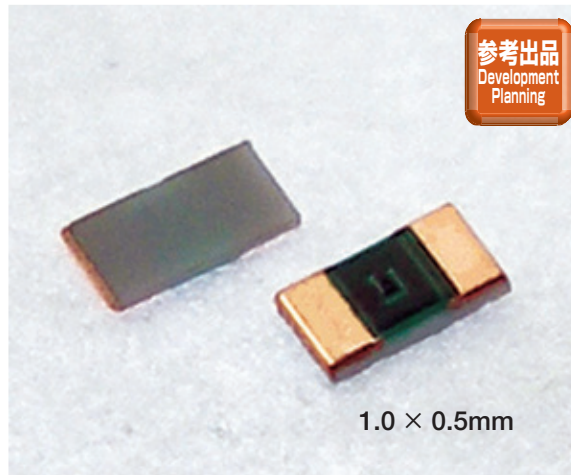
- 汎用品よりも薄い厚さ0.15mm (Max.)
- 銅めっき電極です。
- 広い電極幅を確保しています。

■ Features

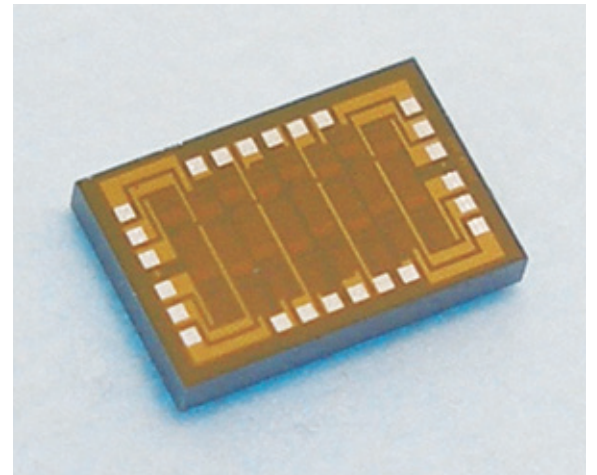
- Thickness 0.15mm Max.
- Copper plating terminations
- Wide area of the terminations is achieved.



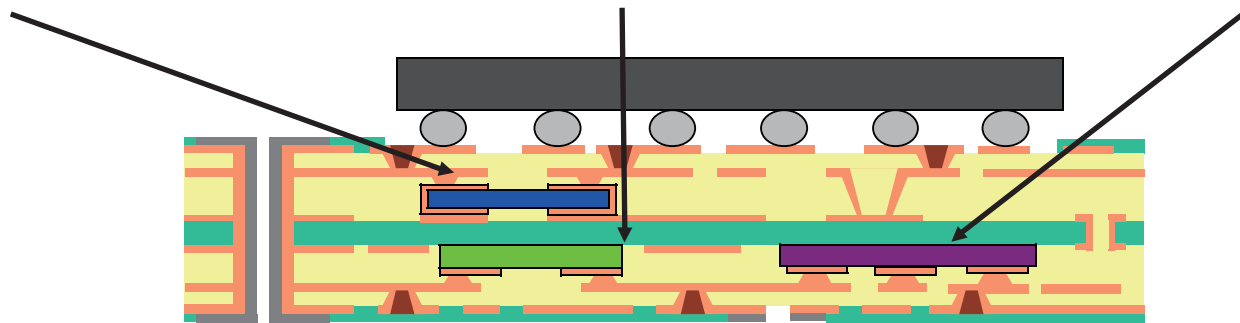
低背厚膜チップ抵抗器 **XR73**
Low Profile Thick Film Chip Resistors



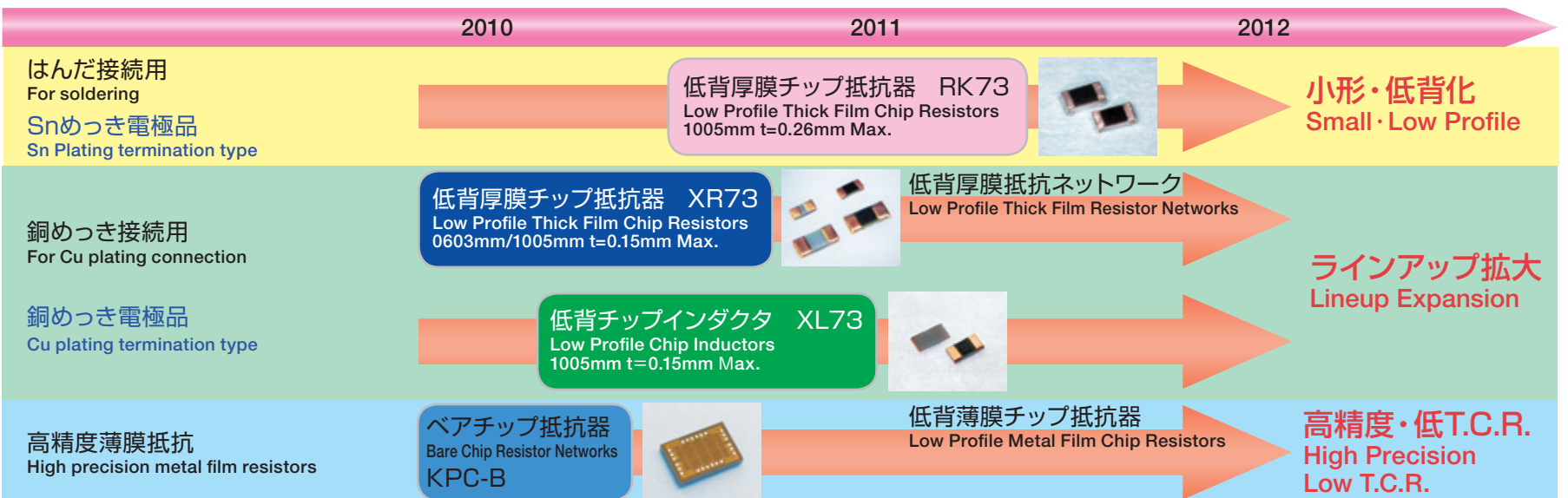
低背チップインダクタ **XL73**
Low Profile Chip Inductors



ベアチップ抵抗器 **KPC-B**
Bare Chip Resistor Networks



■ KOAの基板内蔵用部品ロードマップ Product roadmap for embedded passive device



開発品につき、ご使用に際しましては、弊社担当者にお問い合わせ下さい。 Since this product is still under development, if you are interested in using this product, please contact our sales person.